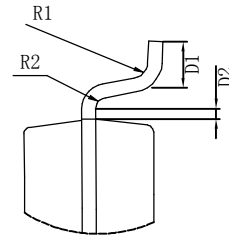
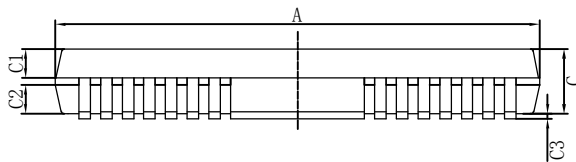
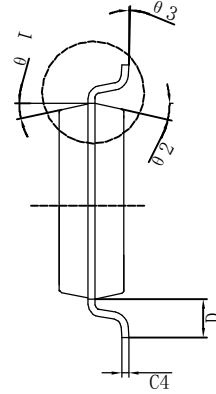
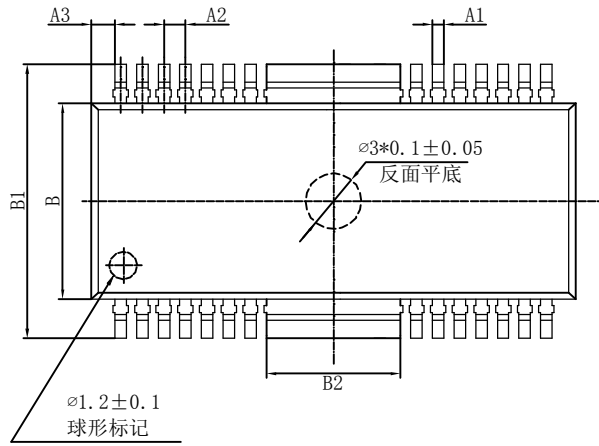




尺寸/ SYMBOL	SIZE	最小/MIN(mm)	最大/MAX(mm)	尺寸/ SYMBOL	SIZE	最小/MIN(mm)	最大/MAX(mm)
A		17.85	18.05	C3		0.03	0.17
A1		0.31	0.51	C4		0.254TYP	
A2		0.80TYP		D		1.353	1.453
A3		0.77TYP		D1		0.60	1.00
B		7.40	7.60	D2		0.18TYP	
B1		10.21	10.41	R1		0.30TYP	
B2		5.00	5.30	R2		0.20TYP	
C		2.13	2.33	θ 1		12° TYP4	
C1		1.05	1.07	θ 2		12° TYP4	
C2		1.05	1.07	θ 3		0° ~ 8°	



制图	石艳	2016.01.29	名称	生效日期		
审核			HSOP28 封装产品图	等级标记	重量	比例
批准						
单位	mm		图号	页数	第1页 共1页	
镀涂			C-OL-040	气派科技股份有限公司		
			版次	D		
				CHINA CHIPPACKING TECH. CO., Ltd		